**华南理工大学2022-2023年度“金发科技奖学金”申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 学 历 |  | | | 学 号 |  | 相片 |
| 性 别 |  | 民 族 |  | | | 籍 贯 |  |
| 政治面貌 |  | 出生年月 |  | | | | |
| 英语等级 |  | | 成绩排名 | | | |  |
| 联系电话 |  | | 邮箱 | | | |  | |
| 学 院 |  | | 导师姓名 | | | |  | |
| 家庭住址 |  | | 特长及爱好 | | | |  | |
| **教育情况（本科及以上）** | | | | | | | | |
| 时间（起止） | | 学校 | | | 专业 | | | 学历 |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
| **家庭情况** | | | | | | | | |
| 与本人关系 | 姓名 | 年龄 | | 工作单位 | | | | 担任职位 |
|  |  |  | |  | | | |  |
|  |  |  | |  | | | |  |
|  |  |  | |  | | | |  |
| **学生工作情况** | | （至少填写4行，段首缩进2字，不要改变表格大小，提交时删除红字） | | | | | | |
| **学生活动** | | （至少填写4行，段首缩进2字，不要改变表格大小，提交时删除红字） | | | | | | |
| **实习情况** | | （至少填写4行，段首缩进2字，不要改变表格大小，提交时删除红字） | | | | | | |
| **专利、论文** | | （至少填写4行，段首缩进2字，不要改变表格大小，提交时删除红字） | | | | | | |
| **个人评价** | | （至少填写4行，段首缩进2字，不要改变表格大小，提交时删除红字） | | | | | | |
| **对金发科技的认识** | | （至少填写4行，段首缩进2字，不要改变表格大小，提交时删除红字） | | | | | | |
| **对“金发科技奖学金”的设立形式、奖励方式等的看法、建议及宝贵意见** | | （至少填写2行，段首缩进2字，不要改变表格大小，提交时删除红字） | | | | | | |
| **学院评审意见** | | （至少填写3行，段首缩进2字，不要改变表格大小，提交时删除红字）  签字（盖章）  年 月 日 | | | | | | |
| **学校评审意见** | | 签字（盖章）  年 月 日 | | | | | | |
| **公司评审意见** | | 签字（盖章）  年 月 日 | | | | | | |